

証券コード: 4004

株式会社 レゾナック・ホールディングス (旧昭和電工)

レゾナックの誕生とその成長戦略

RESONAC

2023年3月11日

目次

① レゾナックの誕生

② 新生レゾナック概観: セグメント・製品紹介

③ 成長戦略の本丸: 半導体材料

④ 業績概要・2025年目標

⑤ おわりに

RESONAC

1

レゾナックの誕生

RESONAC
Chemistry for Change

RESONAC

- ・昭和電工株式会社と昭和電工マテリアルズ株式会社(旧日立化成)は、2023年1月1日に統合し、新会社「レゾナック」へと生まれ変わりました。
- ・当社グループは、新社名でのスタートを第二の創業と捉えています。幅広いステークホルダーのみなさんと共に、時代が求める機能を共に創り出す先端材料パートナーとして、グローバル社会の持続可能な発展に貢献していきます。

RESONAC
Chemistry for Change

総合化学
メーカー

旧昭和電工

売上高
1兆円規模



昭和電工(株)
設立

1939年

昭和電工
マテリアルズ(株)
(旧日立化成)設立

1962年

両社が統合し、
(株)レゾナック誕生

2023年

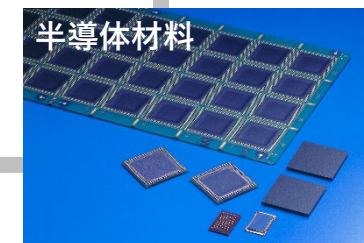
新生レゾナック 誕生

売上高 1兆4,000億円規模

機能性化学
メーカー

旧日立化成

売上高
7,000億円規模



総合化学から、成長性の高いスペシャリティケミカルへ

2

新生レゾナック概観: セグメント・製品紹介

RESONAC
Chemistry for Change

セグメント構成・売上構成比

その他・調整額 8.3%

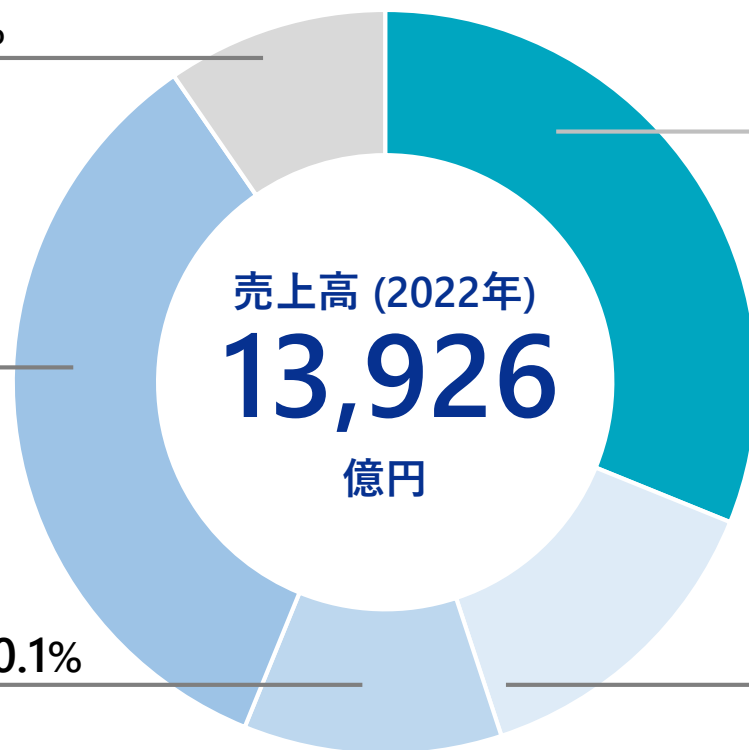
ライフサイエンス関連製品 他

ケミカル 37.9%

石油化学
化学品
黒鉛電極

イノベーション材料 10.1%

機能性化学品、機能性樹脂、
コーティング材料、セラミックス、
アルミ機能部材



売上高 (2022年)
13,926
億円

半導体・電子材料

30.7%(4,272億円)

1. 半導体用高純度ガス
2. CMPスラリー
3. エポキシ封止材
4. ダイボンディング材料
5. 鋼張積層板
6. 感光性フィルム
7. 感光性ソルダーレジスト
8. ハードディスク
9. SiCエピタキシャルウェハー
10. 化合物半導体(LED)

モビリティ 13.0%

自動車部品、リチウムイオン電池材料

半導体・電子材料

半導体製造の前工程・後工程を幅広くカバーする材料ラインナップ
素材の力で先端技術革新を牽引

代表製品

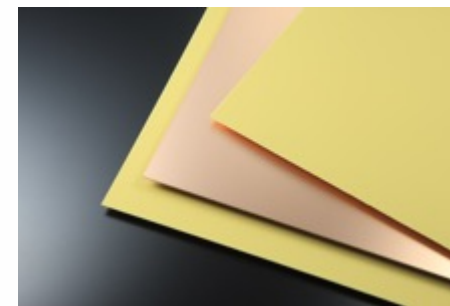
エッチングガス



CMPスラリー



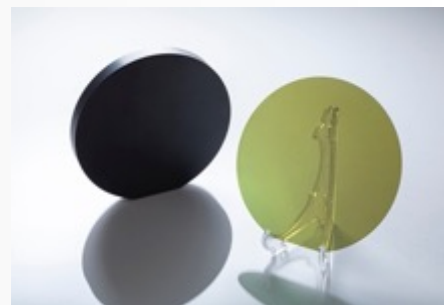
どう ぱり
銅張積層板



ハードディスクメディア



SiCエピタキシャルウェハー



モビリティ

CASE化の進展に伴う軽量化・電動化をはじめ、次世代自動車に求められる製品・技術開発に注力

代表製品

樹脂製バックドア
モジュール



リチウムイオン電池用
負極材



代表製品

エチレン



黒鉛電極



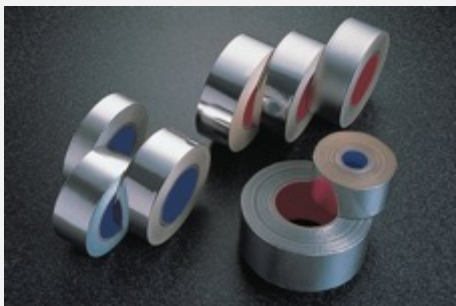
ケミカル

産業の起点・インフラとなる製品を提供
製造工場のCO₂排出量削減などカーボンニュートラルに
向けた技術開発に取り組み

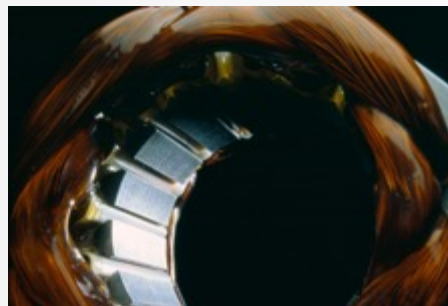
イノベーション材料

当社事業のイノベーションや競争力強化を支える
「技術プラットフォーム」社内外に幅広い技術・素材を提供

合成樹脂エマルジョン「ポリゾール」



電気絶縁ワニス



ノンスティック・コーティング剤



コンデンサー用セラミックス



アルミニウム casting 棒・鍛造品



不飽和ポリエステル



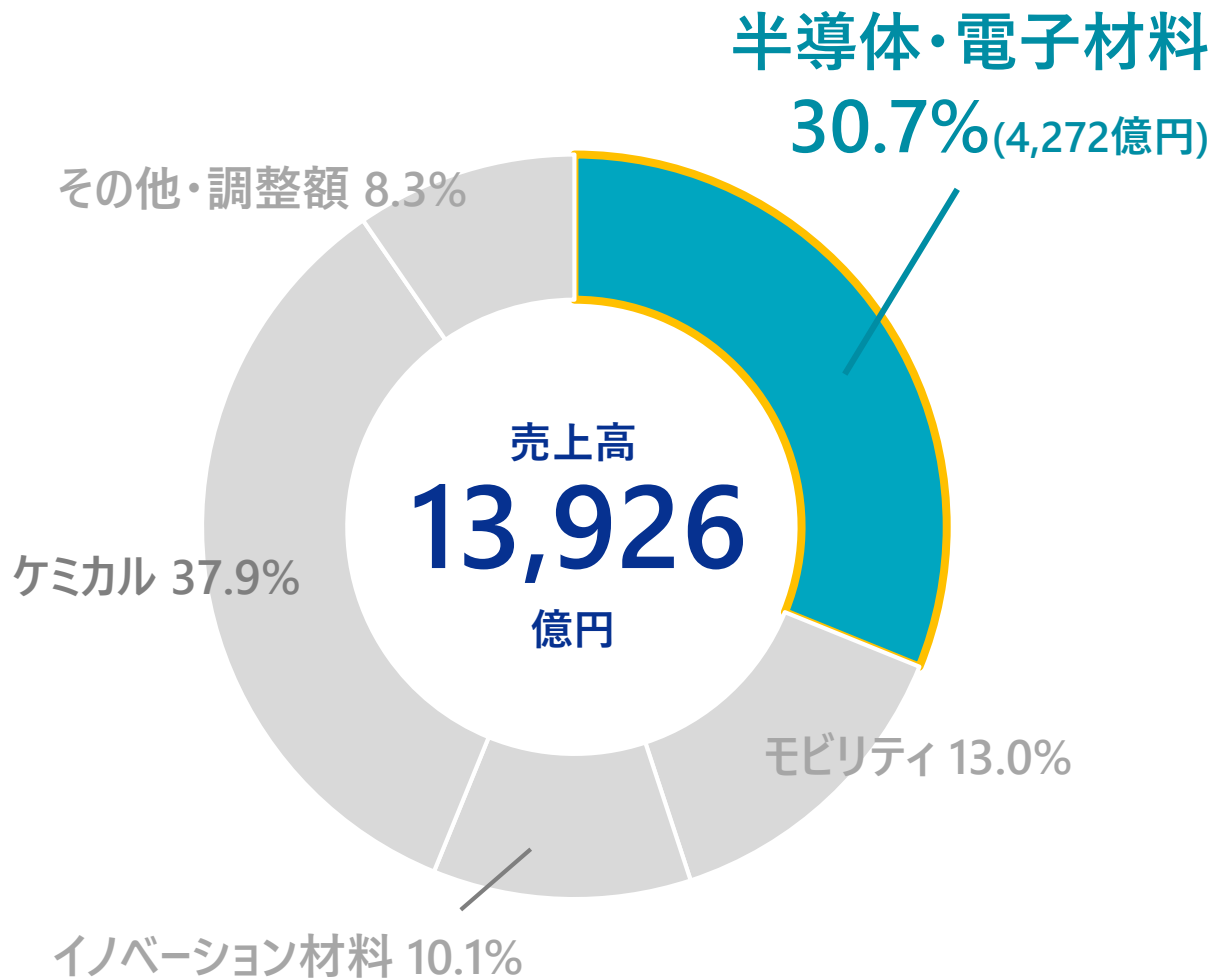
3

成長戦略の本丸: 半導体材料

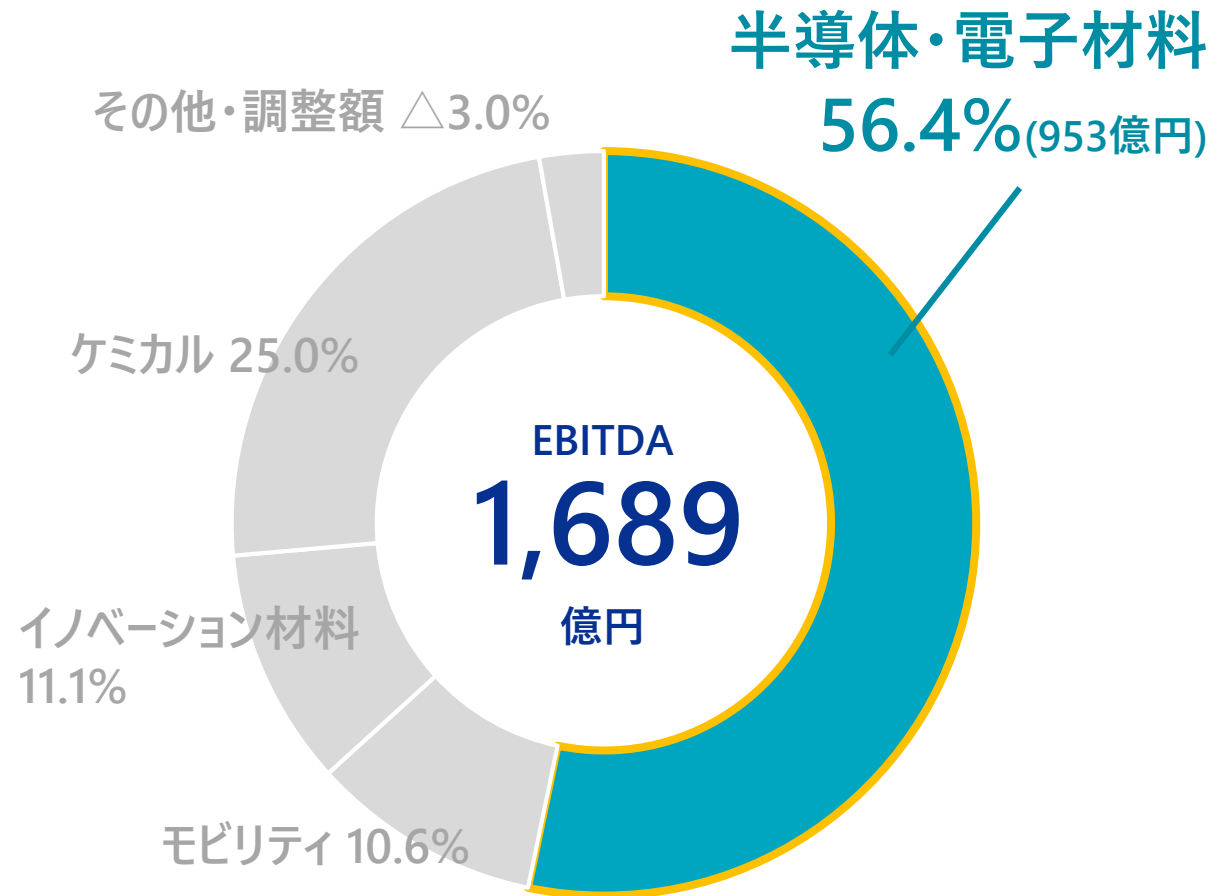
RESONAC
Chemistry for Change

RESONAC

売上高構成比



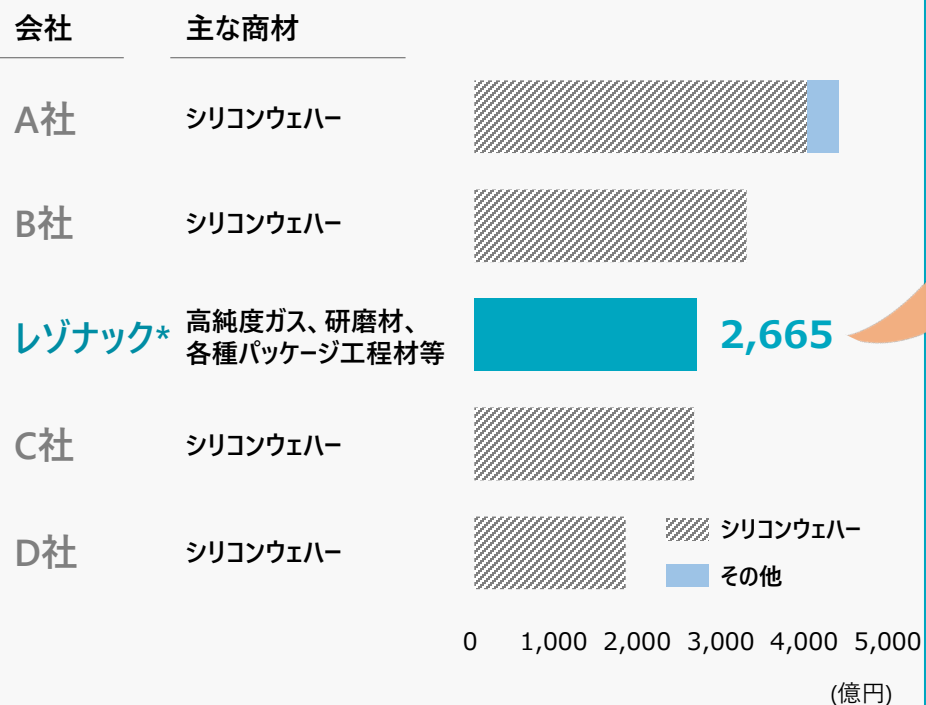
EBITDA*構成比



*EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん等償却費

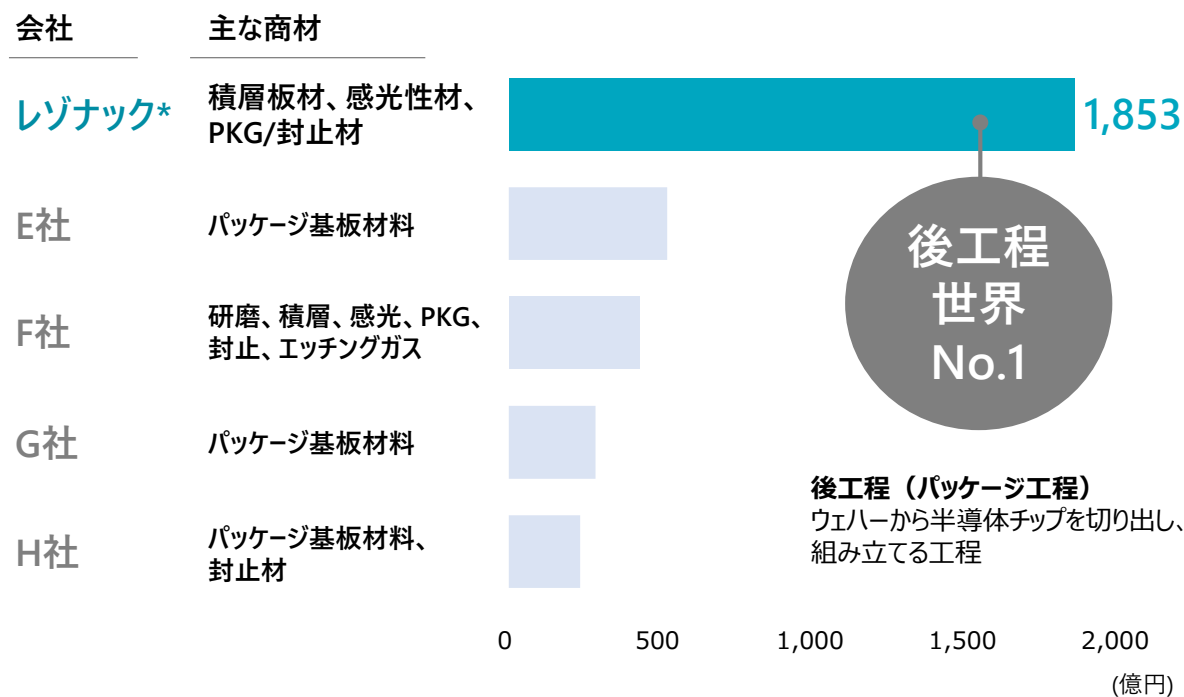
半導体製造「後工程」で圧倒的な存在感

グローバル主要半導体
材料プレイヤーの売上高（2021年実績）



出典：当社調べ（SiCエピウェハーを除く）

後工程（パッケージ工程）



出典：当社調べ

* 2021年時点の社名は昭和電工

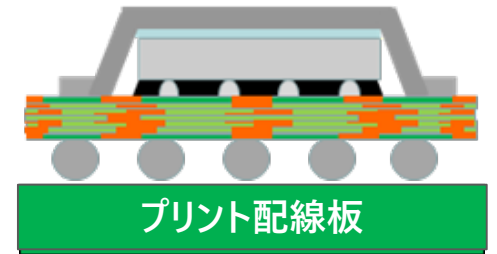
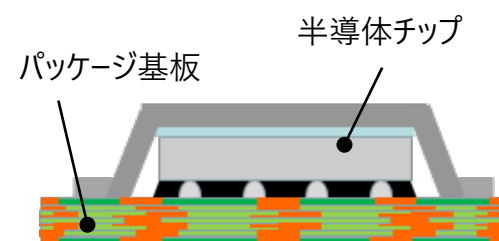
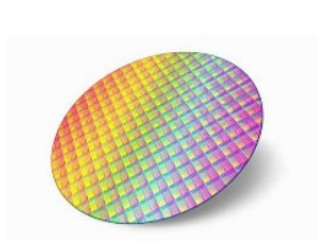
前工程（ウエハ上に回路を形成）

後工程（半導体チップのパッケージング）

シリコンウェハ

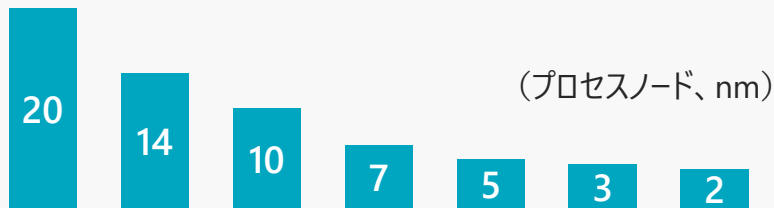
半導体チップ

半導体パッケージ



前工程の微細化を中心とした性能向上は
物理的・経済的に限界

微細化の
推移



(プロセスノード、nm)



後工程での実装技術により、
高機能化の実現へ



QFP

Easy

- 1~2 combination
- Simple evaluation



FC-BGA

Challenging

- 4~5 combination
- Combined evaluation



2.xD

Too complicated

- Over 10 combination
- PKG evaluation

半導体後工程の高度化・複雑化
+
関連する材料数の増加



1つのニーズに対して
すり合わせが必要な
材料数が増加

現行

将来

用途

PC、ゲーム、サーバー

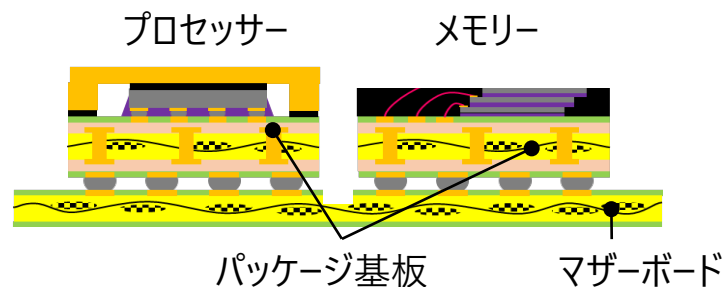
AI、サーバー、ADAS

技術動向

- ・伝送距離を短くするため、部品(プロセッサ、メモリ等)を近くに多く搭載
- ・チップを小型化して積層することで、低コストと高機能を両立

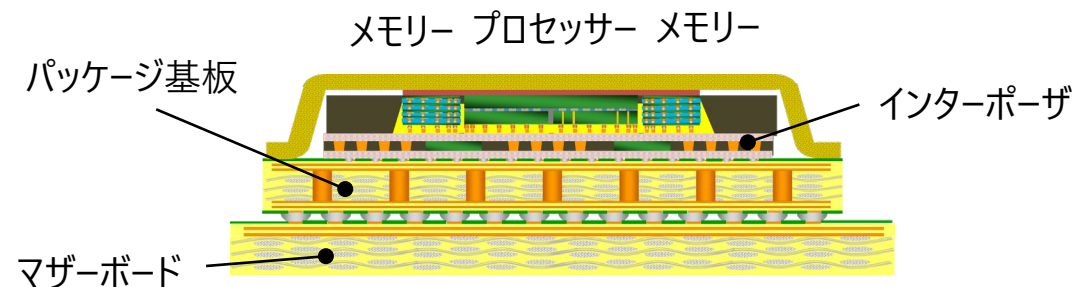
半導体
パッケージ

FC-BGA



- ・パッケージ基板に各半導体チップを搭載
- ・プロセッサとメモリの伝送はマザーボード経由

2.xD, 3Dパッケージ

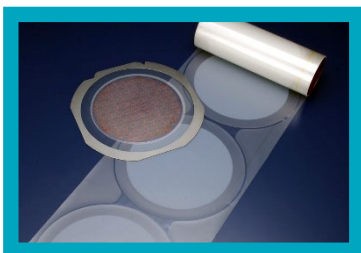


- ・インターポーザ上に各半導体チップを搭載
- ・プロセッサとメモリの伝送はインターポーザ経由



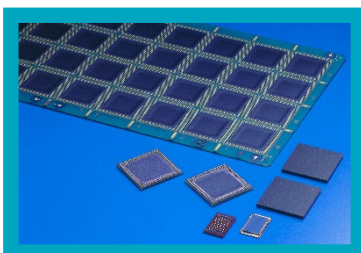
エッチングガス

世界**1**位



ダイボンディングフィルム

世界**1**位



封止材

世界**2**位



液状アンダーフィル

世界**2**位



CMPスラリー セリアスラリー

世界**1**位



銅張積層板 半導体パッケージ基板用

世界**1**位



感光性フィルム

世界**1**位



ソルダーレジスト

半導体パッケージ基板用 大型パッケージ基板用

世界**2**位

世界**1**位

半導体後工程における半導体材料 (2.x/3Dパッケージの例)



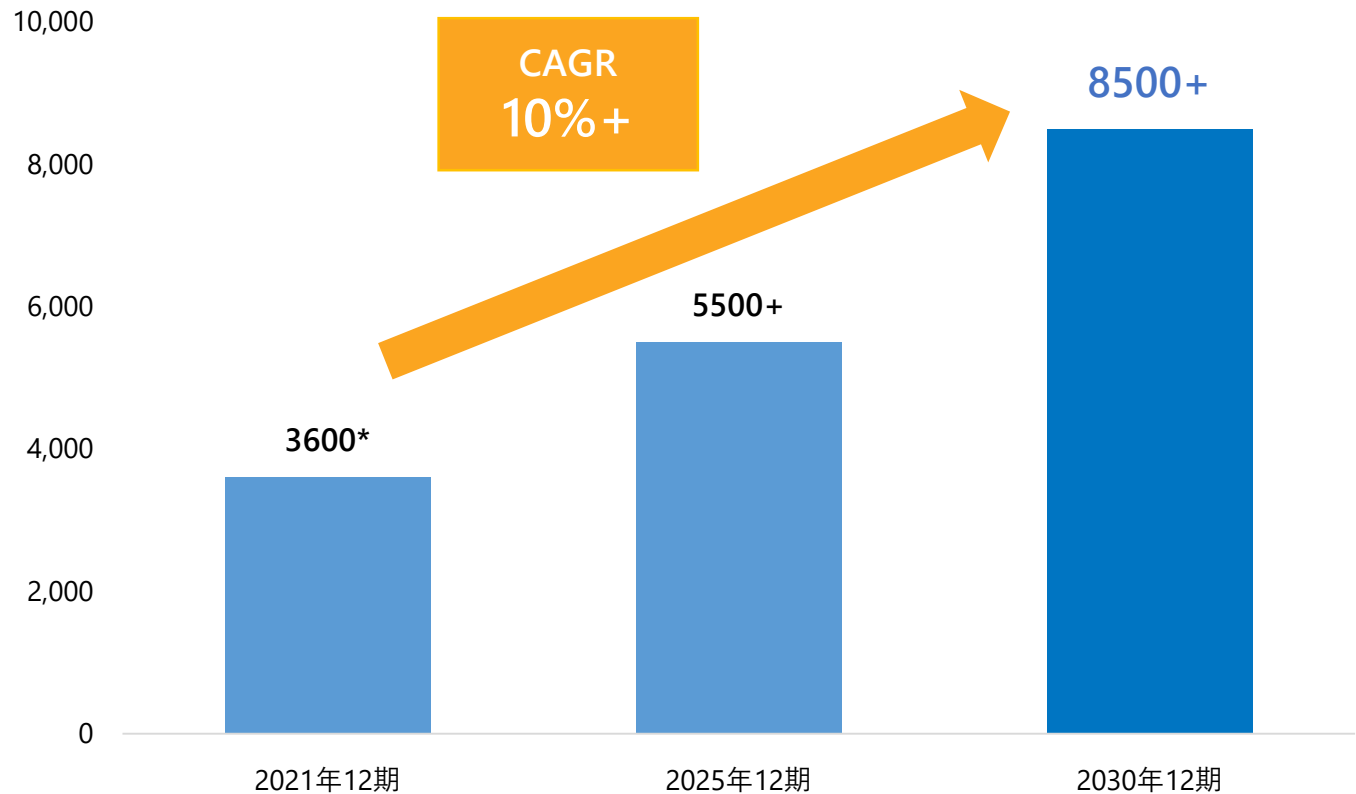
*1: HDマイクロシステムズ(株)によるバッファコート/感光性絶縁材市場シェア、*2: 上記製品の市場シェアは全て当社調べ

最近の投資実績

2021年 1月	ハードディスク用アルミニウム基板の生産能力を増強
2022年 3月	SiCパワー半導体向け単結晶基板の量産開始
2022年 6月	SK Inc.マテリアルズとの合弁会社「SK昭和電工」のHBr製造プラントが7月に竣工
2022年 8月	CMPスラリーの生産能力と評価機能を増強
2022年 9月	半導体パッケージ基板用銅張積層板の生産能力を増強

半導体・電子材料事業の中期売上見通し

(単位：100万ドル)



* 「2022年2月当社発表『共創型化学会社』に向けて目指す方向性 [pdf-ir-library-irpresentation-vision202202_j.pdf \(www.resonac.com\)](https://www.resonac.com/pdf-ir-library-irpresentation-vision202202_j.pdf)」から成長事業の売上見通しについて 対象範囲を半導体・電子材料事業へ変更

コモディティー化しない 領域

かつて薄型テレビや太陽電池などの分野では、品質アップが極限に達した段階で各部品の低価格化とコモディティー化が起きた。

同様のことは「すり合わせ型」の半導体材料分野では起きない。

大事ななのは 顧客との接点

後発メーカーは、半導体メーカーなどとの共同研究や生産現場、アフターサービスでの顧客課題に触れる機会が少なく、技術動向や顧客ニーズを把握できないため、技術開発、サービス開発などで不利。

変更されにくい 生産プロセス

半導体メーカーは採算への影響を優先して、生産プロセスの変更を避ける傾向にある。

ソリューション最適化の 複雑性

電気工学（伝導性）、熱力学（熱伝導）、構造力学、物性化学のパラメータが同時に動く中で最適解となる材料設計をする難しさがある。

参入障壁が高い

前工程 (ウェハー工程)

後工程 (パッケージ工程)

旧日立化成 (混ぜる化学)

セリアスラリー
世界No.1



世界No.1



世界No.1



エッチングガス
世界No.1



高純度
溶剤



+

SiCエピ
ウェハー



世界トップクラス

世界No.2



半導体パッケージ基板用
世界No.1

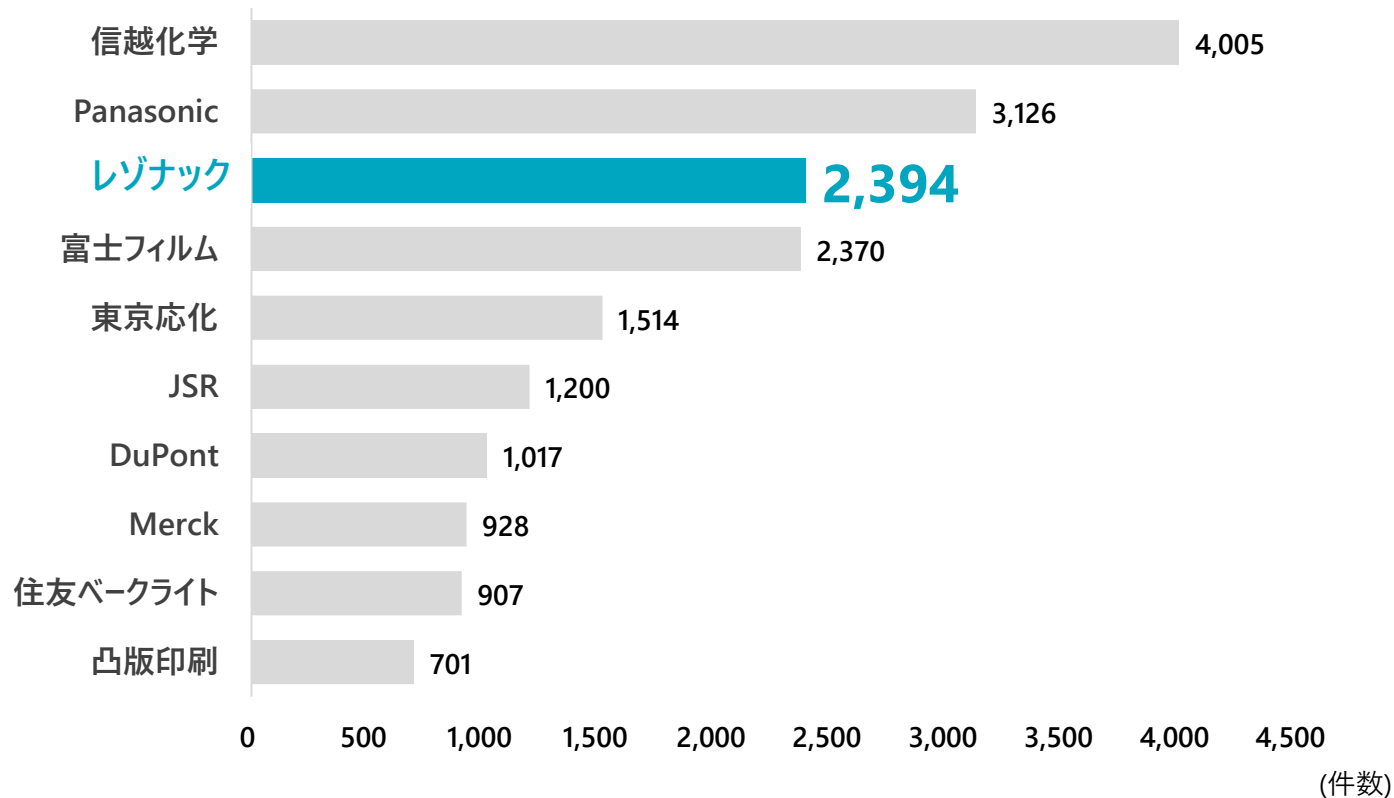


旧昭和電工 (作る化学)

作る化学 + 混ぜる化学

前工程から後工程まで
半導体材料分野を
幅広くカバー

特許の量的価値



保有する特許はグローバル企業と肩を並べるポジションへ

統合シナジーで始まった次世代材料の開発例

■ 銅張積層板

電気を高速に流すため、従来品とは異なる種類の樹脂開発がスタート

■ ソルダーレジストフィルム

さらに高機能化するための次世代材料開発がスタート

■ CMPスラリー

新たな研磨剤成分（砥粒）の検討を開始

出典：PatentSightデータベース（半導体分野の技術分類コードを用いて生存特許を抽出）

4

業績概要・2025年目標

RESONAC
Chemistry for Change

RESONAC

連結業績の概要

(億円)

項目	2021年	2022年	増減
売上高	14,196	13,926	△ 270
営業利益	872	594	△ 278
経常利益	869	594	△ 275
親会社株主に帰属する 当期純利益	△ 121	308	429
EBITDA 営業利益+減価償却費+のれん等償却費	2,026	1,689	△ 337
EBITDAマージン(対売上)	14.3%	12.1%	△ 2.1p
ROIC 投下資本利益率 (営業利益+持分法投資損益-法人税)÷ (有利子負債+純資産)	4.3%	3.2%	△ 1.1p

1株当たり当期純利益	△ 77円 40銭	170円 03銭	247円 43銭
1株当たり期末配当金	65円	65円(予定)	-

(参考) (億円)

継続事業ベース ※			
	2021年	2022年	増減
売上高	12,489	13,828	1,339
営業利益	781	600	△ 180

EBITDA	1,867	1,696	△ 172
EBITDA マージン	15.0%	12.3%	△ 2.7p

※ 2021年に事業譲渡したアルミ缶・圧延品、食品包装用ラップ、プリント配線板、蓄電デバイス、2022年に事業譲渡したISOLITE GmbHを除いた参考値(監査対象外)

セグメント別売上高・営業利益

(億円)

セグメント		2021年	2022年	増減
半導体・電子材料	売上高	4,229	4,272	42
	営業利益	496	442	△53
モビリティ	売上高	1,738	1,806	68
	営業利益	△ 20	△ 15	5
イノベーション材料	売上高	1,433	1,411	△22
	営業利益	136	98	△38
ケミカル	売上高	4,310	5,278	968
	営業利益	379	249	△130
その他・調整額	売上高	2,486	1,159	△1,326
	営業利益	△ 119	△ 181	△62
合計	売上高	14,196	13,926	△270
	営業利益	872	594	△278

連結貸借対照表

(億円)

資産	2021年	2022年	増減
現預金	2,362	1,871	△ 491
営業債権	2,786	2,655	△ 132
たな卸資産	2,039	2,506	467
その他流動資産	798	850	52
流動資産計	7,985	7,882	△ 103
有形固定資産	6,595	6,819	224
無形固定資産	5,225	4,943	△ 281
(うち、のれん)	3,118	2,954	△ 164
(うち、その他無形固定資産)	2,107	1,990	△ 117
投資その他の資産	1,618	1,360	△ 259
固定資産計	13,439	13,122	△ 316
資産合計	21,424	21,004	△ 420

負債・純資産	2021年	2022年	増減
営業債務	2,077	1,954	△ 124
有利子負債	8,506	10,661	2,155
その他負債	2,656	2,643	△ 13
負債計	13,239	15,257	2,018
株主資本	4,336	4,421	85
(うち、利益剰余金)	1,433	1,634	201
その他の包括利益累計額	804	1,082	278
(うち、その他有証評価差額金)	28	6	△ 23
(うち、為替換算調整勘定)	384	720	336
非支配株主持分	3,045	244	△ 2,800
純資産計	8,185	5,747	△ 2,438
負債・純資産合計	21,424	21,004	△ 420

(億円)

セグメント		2023年 第1四半期 予想
半導体・電子材料	売上高	800
	営業利益	△ 105
モビリティ	売上高	430
	営業利益	△ 15
イノベーション材料	売上高	330
	営業利益	15
ケミカル	売上高	1,340
	営業利益	20
その他・調整額	売上高	300
	営業利益	△ 55
合計	売上高	3,200
	営業利益	△ 140

- 2023年12月期の通期連結業績予想は、先行きの不透明さから、現時点では合理的な予想の算定が困難であることから、**現時点で未定とし**、第1四半期予想のみ算定・開示している。
- 合理的な算定が可能になったタイミングで速やかに開示予定。
- 2023年は第1四半期の連結業績予想は、データセンター向けハードディスク需要の落ち込み、半導体材料顧客の在庫調整を受けて△140億の営業赤字を予想。

指標	単位	2021 実績	2022 実績	2025 目標
売上	(兆円)	1.4	1.4	1兆円超
EBITDAマージン (対売上)	(%)	14.3%	12.1%	20%
ROIC	(%)	4.3%	3.2%	中長期的に 10%
ネットD/Eレシオ*	(倍)	1.15	1.08	1.0倍 を目指す

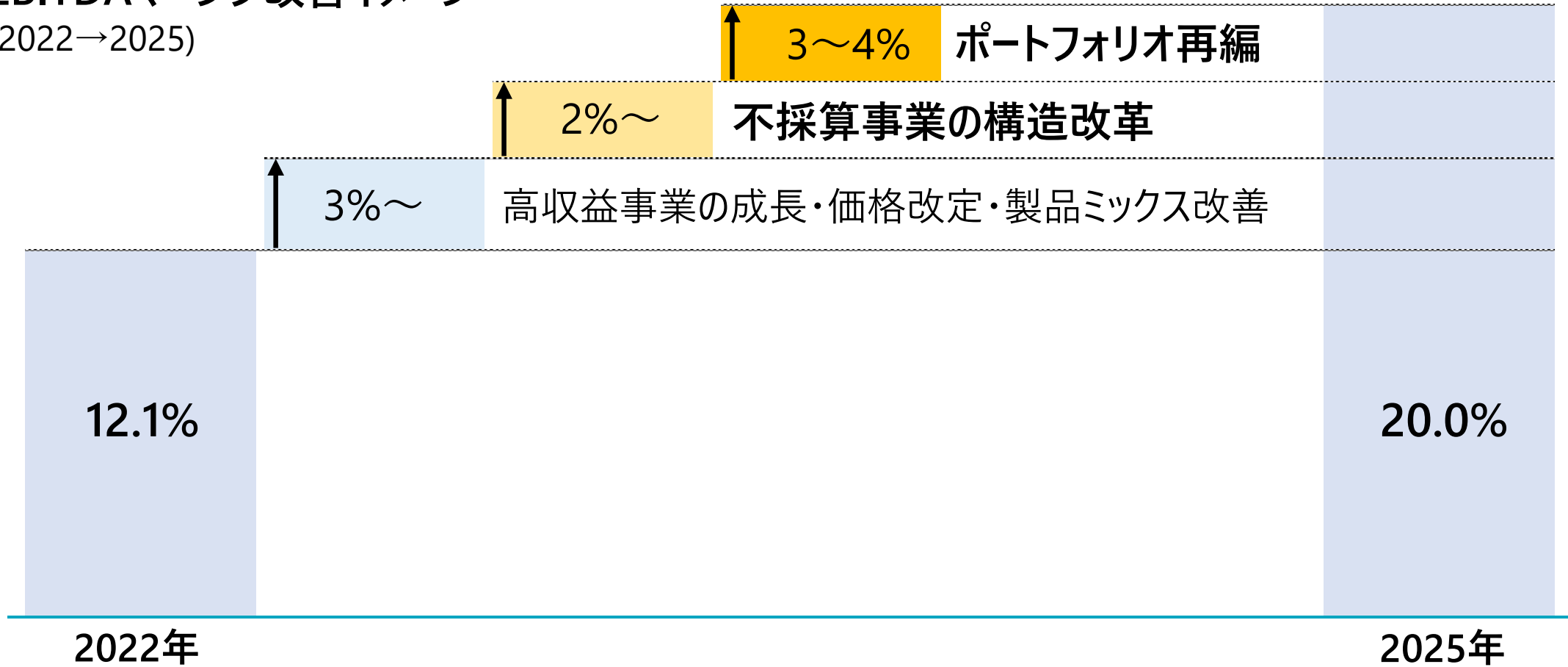
足元の業績は苦戦も、2025年の財務指標目標達成に欠かせない
成長セグメントへの先行投資ならびに構造改革を揺るぎなく行っていく

* '21/12末：{(借入金+コマーシャルペーパー+社債+リース債務) - 現金及び預金 + 優先株×50%} ÷ (自己資本+優先株×50%)

'22/12末：{(借入金+コマーシャルペーパー+社債+リース債務) - 現金及び預金 - 劣後ローン×50%} ÷ (自己資本+劣後ローン×50%)

優先株、劣後ローン(借入金に含まれる)の50%の資本性は、それぞれ2020年4月21日付、同年4月27日付の(株)日本格付研究所の格付に基づく

EBITDAマージン改善イメージ (2022→2025)



事業成長と構造改革を通じ、2025年にEBITDAマージン20%を達成する

収益性を抜本的に改善するため、2025年までに 構造改革を推進

ポートフォリオ再編

コア収益事業への更なる資源集中

ライフサイエンス事業について、外部パートナーとのアライアンスを含めた戦略的オプションを検討する

赤字製品の撲滅

全社横断で赤字製品を値上げまたは撤退

資本効率の追求

不稼働資産の売却および拠点統廃合

5

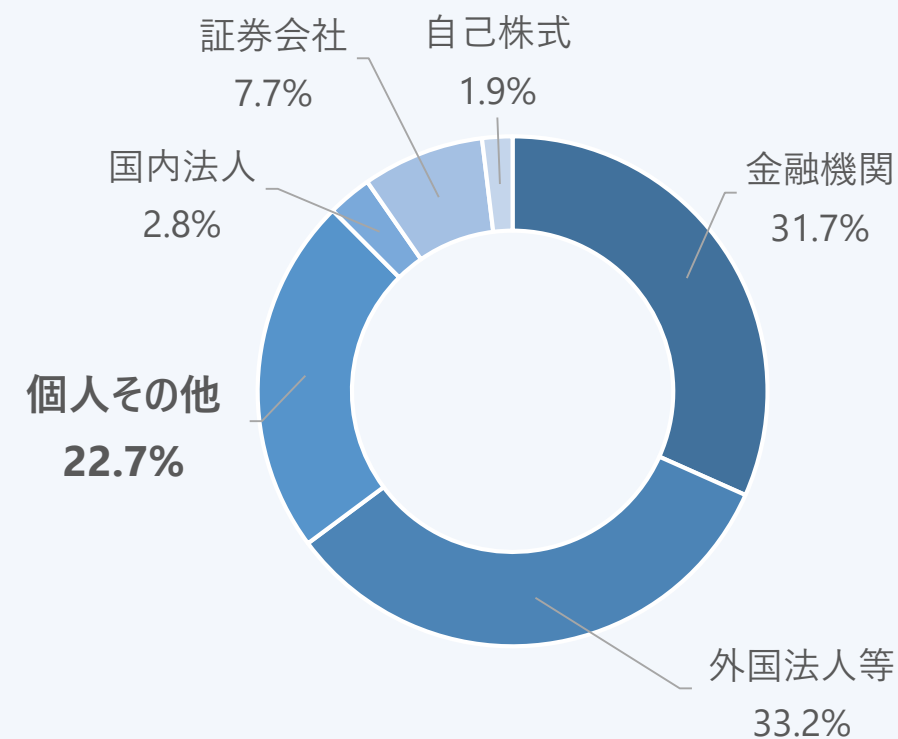
おわりに

RESONAC
Chemistry for Change

株式の概要

上場取引所	東京証券取引所 プライム市場	
証券コード	4004 (化学) 「日経225」構成銘柄	
株主確定基準日	定時株主総会・期末配当 中間配当	12月31日 6月30日
単元株式数	100株	
発行済株式数 (2022年12月末日現在)	184,901,292株	
株主数 (2022年12月末日現在)	90,689名	
株式名簿管理人	みずほ信託銀行株式会社	

所有者別株式状況



(2022年12月末日現在)

レゾナックIR ウェブサイト



<https://www.resonac.com/jp/ir>

開示資料の他、財務ツール、事業概要をまとめたコンテンツなど、より深く当社をお知り頂ける情報を発信しています。

IRメール配信サービス



プレスリリース等のIR情報配信をご希望の方に、タイムリーにメールでお知らせするサービスを行っております。

https://www.resonac.com/jp/ir/ir_mail.html

この機会にぜひご登録ください。

注意事項

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。

なお、法令に定めのある場合を除き、当社はこれらの将来予測に基づく記述を更新する義務を負いません。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績に影響を与える要素には、新型コロナウイルス感染症拡大が世界経済に与える影響、国際情勢、ナフサ等原材料価格、黒鉛電極等製品の需要動向および市況、為替レートなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

RESONAC

Chemistry for Change